

元大證券股份有限公司等包銷鴻勁精密股份有限公司(股票代號：7769) 初次上市前公開承銷普通股股票銷售辦法公告

(本案公開申購係以實際承銷價格預扣價款，適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定)

(本案投標人需繳交投標保證金，如得標後不履行繳款義務者，除喪失得標資格外，證券承銷商就投標保證金應沒入之)

元大證券股份有限公司等共同辦理鴻勁精密股份有限公司（以下簡稱鴻勁或該公司）普通股股票初次上市承銷案(以下簡稱本次承銷案)公開銷售之總股數為 16,497 仟股對外辦理公開銷售，其中 13,198 仟股以競價拍賣方式為之，業已於 114 年 11 月 18 日完成競價拍賣作業，3,299 仟股則以公開申購配售辦理，過額配售為 0 仟股。茲將銷售辦法公告於後：

一、承銷商名稱、地址、總承銷數量、證券承銷商採競價拍賣及公開申購配售數量：

單位：仟股

承銷商名稱	地址	競價拍賣 包銷股數	公開申購 包銷股數	過額配售 股數	總承銷股數
主辦承銷商：					
元大證券股份有限公司	台北市大安區仁愛路三段 157 號 5 樓	13,198	2,499	-	15,697
協辦承銷商：					
富邦綜合證券股份有限公司	台北市大安區敦化南路一段 111 號 9 樓	-	200	-	200
中國信託綜合證券股份有限公司	台北市南港區經貿二路 168 號 3 樓	-	200	-	200
玉山綜合證券股份有限公司	台北市松山區民生東路三段 158 號 6 樓	-	200	-	200
第一金證券股份有限公司	台北市中山區長安東路一段 22 號 10 樓	-	200	-	200
合 計		13,198	3,299	-	16,497

二、承銷價格：每股新臺幣 1,495 元整(每股面額新臺幣壹拾元整)

三、本案適用掛牌後首五交易日無漲跌幅限制之規定，投資人應注意交易之風險。

四、初次上市承銷案件，主辦承銷商執行過額配售及價格穩定措施之相關資訊及發行公司股東自願送存集保股份佔上市掛牌資本額之比例及自願送存集保期間：

(一)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，主辦證券商已與鴻勁簽定「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」，惟實際過額配售股數為 0 仟股。

(二)特定股東限制：依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，主辦證券承銷商已與鴻勁簽定「過額配售及特定股東閉鎖期協議書」，除依規定提出強制集保股份外，另由鴻勁公司協調特定股東，就其所持有之已發行普通股股票自願送存集保，兩者合計 97,225,912 股，分別占申請上市掛牌股數總額 161,600,000 股之 60.16%，以及上市掛牌時擬發行股份總額 179,930,000 股之 54.04%，另特定股東於掛牌日起三個月內自願送存臺灣集中保管結算所股份有限公司集保並不得賣出，以維持承銷價格穩定。

五、初次上市承銷案件，是否因公開申購配售之申購狀況而調整詢價圈購、公開申購配售數量之情事者，應予以揭露：不適用。

六、競價拍賣、公開申購及過額配售之數量限制：

(一)競價拍賣數量：競價拍賣最低每標單位為 1 張(仟股)，每一投標單最高投標數量不超過 1,649 張(仟股)，每一投標人最高得標數量不得超過 1,649 張(仟股)，投標數量以 1 張(仟股)之整倍數為投標單位。

(二)公開申購數量：每壹銷售單位為 1 仟股，每人限購 1 單位(若超過壹申購單位，即全數取消申購資格)。

(三)過額配售數量：無。

(四)承銷商於辦理配售作業時，應依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理。

七、公開申購期間、申購手續及申購時應注意事項：

(一)申購期間業已於 114 年 11 月 17 日起至 114 年 11 月 19 日完成；申購處理費、中籤通知郵寄工本費及申購價款(以實際承銷價格為之)繳存往來銀行截止日為 114 年 11 月 19 日；申購處理費、中籤通知郵寄工本費及申購價款(以實際承銷價格為之)扣繳日為 114 年 11 月 20 日(扣繳時點以銀行實際作業為準)。

(二)申購人申購時，需確認申購截止日銀行存款餘額應有申購處理費、認購價款(以實際承銷價格為之)及中籤通知郵寄工本費之合計金額供銀行執行扣款。如有數個有價證券承銷案於同一天截止申購，當申購人投件參與其中一個以上案件時，銀行存款之扣款應以所申購各案有價證券處理費、認購價款(以實際承銷價格為之)及中籤通知郵寄工本費之合計總額為準，否則全數為不合格件。

(三)申購人申購後，往來銀行於扣繳日 114 年 11 月 20 日將辦理申購處理費、認購價款(以實際承銷價格為之)及中籤通知郵寄工本費扣繳事宜(扣繳時點以銀行實際作業為準)。如申購人此時銀行存款不足申購處理費、認購價款(以實際承銷價格為之)及中籤通知郵寄工本費三項總計之金額，將視為不合格件。

(四)申購人之申購投件一旦被列為不合格件，則將取消申購資格，證券經紀商於公開抽籤日次一營業日上午十點前(114 年 11 月 24 日)，併同未中籤之申購人之退款作業，退還中籤通知郵寄工本費及申購有價證券價款(均不加計利息)，惟申購處理費不予退回。

八、公開申購銷售處理方式及抽籤時間：

(一)相關作業請參考「中華民國證券商業同業公會證券商辦理公開申購配售作業處理程序」及「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」。

(二)證交所應於抽籤前，將銀行存款不足無法如期扣繳申購處理費、申購價款(以實際承銷價格為之)、中籤通知郵寄工本費之合計金額及重複申購之資料予以剔除，並應於申購截止日之次一營業日完成上述合格件及不合格件之篩選，重複申購者已扣繳之處理費不予退還，並由承銷商於承銷期間截止後一週內以掛號函件通知申購人。

(三)如申購數量超過銷售數量時，則於 114 年 11 月 21 日上午九時起在臺灣證券交易所電腦抽籤室(臺北市信義路五段七號十樓)，以公開方式就合格件辦理電腦抽籤作業抽出中籤人，其方式依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理，並由證交所邀請發行公司代表出席監督。

九、公開申購人經中籤後不能放棄認購及要求退還價款，申購前應審慎評估。

十、通知及(扣)繳交價款日期與方式：

(一)競價拍賣部分：

1.得標人之得標價款及得標手續費繳存往來銀行截止日為 114 年 11 月 20 日止，得標人應繳足下列款項：

(1)得標價款：得標人應依其得標價款認購之，應繳之得標價款，應扣除已扣繳之投標保證金後為之。

(2)得標手續費：

依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第十二條規定，承銷商得向得標人收取得標手續費。本次承銷案件得標人每一得標單應繳交得標價款之 4% 之得標手續費，並併同得標價款於銀行繳款截止日(114 年 11 月 20 日)前存入往來銀行。

每一得標單之得標手續費：每股得標價格 × 得標股數 × 4%。

(3)得標人得標價款及得標手續費扣繳日：114 年 11 月 21 日(依銀行實際之扣款作業為準)。

2.得標人未如期履行繳款義務時，除喪失得標資格外，投標保證金應由主辦承銷商沒入之，並依該得標人得標價款自行認購。

3.如有數個有價證券承銷案於同一天截止繳交得標價款及得標手續費，當投資人投標參與其中一個以上案件，或就同一競價拍賣案件有多筆得標單時，銀行存款之扣款應以已繳保證金較高者優先扣款，如金額相同者，以得標應繳價款及得標手續費合計總額較高者優先扣款，如金額相同者，以投標單輸入時間先後順序扣款。

4.未得標及不合格件保證金退款作業：經紀商業於開標日次一營業日(114年11月19日)上午十點前，依證交所電腦資料，指示往來銀行將未得標(包括單一投標單部份未得標)及不合格件之保證金不加計利息予以退回，惟投標處理費不予退回。

(二)公開申購部份：

申購處理費、中籤通知郵寄工本費及申購價款(以實際承銷價格為之)扣繳日為114年11月20日(扣繳時點以銀行實際作業為準)。

(三)實際承銷價格(公開申購價格)訂定之日期為114年11月18日，請於當日上午十時自行上網至臺灣證券交易所網站(<https://www.twse.com.tw>)免費查詢。

(四)如有辦理過額配售時，係採公開申購方式，並依中華民國證券商業同業公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」及「證券商辦理公開申購配售作業處理程序」辦理。

(五)投資人銀行存款不足同時支應投標保證金、投標處理費、得標價款、得標手續費、申購處理費、申購認購價款(以實際承銷價格為之)、中籤通知郵寄工本費及交易市場之交割價款時，應以交割價款為優先，次為得標價款及得標手續費，再為申購處理費、申購認購價款(以實際承銷價格為之)及中籤通知郵寄工本費，最後為投標保證金及投標處理費。

十一、未中籤人之退款作業：將於公開抽籤次一營業日(114年11月24日)，依證交所電腦資料，將中籤通知郵寄工本費及認購價款退還未中籤申購人(均不加計利息)，惟申購處理費不予退回。

十二、公開申購之中籤名冊及競價拍賣得標名單之查詢管道：

(一)公開申購：

1.可參加公開抽籤之合格清冊，將併同不合格清冊，於公開抽籤日，備置於收件經紀商(限所受申購部分)，臺灣證券交易所股份有限公司及主辦承銷商營業處所，以供申購人查閱。

2.由承銷商於公開抽籤日次一營業日以限時掛號寄發中籤通知書及公開說明書等。

3.申購人可以向原投件證券經紀商查閱中籤資料。

(二)競價拍賣：

開標日後，投標人可於「承銷有價證券競價拍賣系統」或向開戶證券經紀商查詢。

十三、有價證券發放日期、方式與特別注意事項：

(一)鴻勁於股款募集完成後，通知集保結算所於114年11月27日將股票直接劃撥至認購人指定之集保帳戶，並於當日上市(實際上市日期以發行公司及臺灣證券交易所股份有限公司公告為準)。

(二)認購人帳號有誤或其他原因致無法以劃撥方式交付時，認購人須立即與所承購之承銷商辦理後續相關事宜。

十四、有價證券預定上市日期：114年11月27日(實際上市日期以發行公司及臺灣證券交易所股份有限公司公告為準)。

十五、投資人應詳閱本銷售辦法、公開說明書及相關財務資料，並對本普通股股票之投資風險自行審慎評估，鴻勁及各證券承銷商均未對本普通股股票上市後價格為任何聲明、保證或干涉，其相關風險及報酬均由投資人自行負擔。如欲知其他財務資料可參閱公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw>)或發行公司網址：<https://www.honprec.com>)。

十六、公開說明書之分送、揭露及取閱地點：

(一)有關該公司之財務及營運情形已詳載於公開說明書，投資人得上網至公開資訊觀測站網

站查詢(<https://mops.twse.com.tw>→單一公司→電子文件下載)，或至主、協辦證券承銷商網站免費查詢，網址：元大證券股份有限公司(<https://www.yuanta.com.tw>)、富邦綜合證券股份有限公司(<https://www.fubon.com.tw>)、中國信託綜合證券股份有限公司(<https://www.ctbcsec.com>)、玉山綜合證券股份有限公司(<https://www.esunsec.com.tw>)及第一金證券股份有限公司(<https://www.firstsec.com.tw>)。

- (二)競價拍賣開標後，承銷商應將「得標通知書」及「公開說明書」以限時掛號寄予得標投資人；另應於公開申購結束後，將「公開說明書」、「中籤通知書」以限時掛號寄發中籤人。

十七、會計師最近三年度及最近期財務資料之查核簽證意見：

年度	簽證會計師事務所	簽證會計師姓名	查核簽證意見
111 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	黃惠敏、邵志明	無保留意見
112 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	黃惠敏、邵志明	無保留意見
113 年度	勤業眾信聯合會計師事務所	黃惠敏、邵志明	無保留意見
114 年第三季	勤業眾信聯合會計師事務所	黃惠敏、邵志明	保留結論

十八、財務報告如有不實，應由發行公司及簽證會計師依法負責。

十九、特別注意事項：

- (一)認購人於認購後、有價證券發放前死亡者，其繼承人領取時，應憑原認購人死亡證明書、繼承人之國民身分證正本(未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人國民身分證正本代之)、繼承系統表、戶籍謄本(全戶及分戶)、繼承人印鑑證明(未成年人應加法定代理人印鑑證明)、遺產稅證明書，繼承人中有拋棄繼承者應另附經法院備查之有價證券繼承拋棄同意書及其他有關文件辦理。
- (二)申購人有左列各款情事之一者，經紀商不得受託申購，已受理者應予剔除：
- 1.於委託申購之經紀商未開立交易戶、款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶者。
 - 2.未與經紀商指定之往來銀行就公開申購相關款項扣繳事宜簽訂委託契約書。
 - 3.未於規定期限內申購者。
 - 4.申購委託書應填寫之各項資料未經填妥或資料不實者。
 - 5.申購委託書未經簽名或蓋章者，惟以電話或網際網路委託者不在此限。
 - 6.申購人款項劃撥銀行帳戶之存款餘額，低於所申購有價證券處理費、認購價款及中籤通知郵寄工本費之合計金額者。
 - 7.利用或冒用他人名義申購者。
- (三)本次參與有價證券承銷申購之人，於中籤後發現有違反前述第(一)、(二)項之規定，應取消其認購資格者，其已扣繳認購有價證券款項應予退還；但已扣繳之申購處理費及中籤通知郵寄工本費不予退還。前項經取消認購資格之認購人及經取消認購資格之繼承人，欲要求退還已繳款項時，應憑認購人或其繼承人身分證正本(法人為營利事業登記證影本，未滿十四歲之未成年人，得以戶口名簿正本及法定代理人身分證正本代之)，洽原投件證券經紀商辦理。
- (四)申購人不得冒用或利用他人名義或偽編國民身分證字號參與。證券商經發現有冒用、利用他人名義或偽編國民身分證字號參與有價證券申購者，應取消其參與申購資格，處理費用不予退還；已認購者取消其認購資格；其已繳款項，不予退還。
- (五)若於中籤後發現有中籤人未開立或事後註銷交易戶、款項劃撥銀行帳戶或集中保管帳戶情事，致後續作業無法執行者，應取消其其中籤資格。
- (六)證券交易市場因天然災害或其他原因致集中交易市場休市時，有關投標截止日、開標日、投標處理費、投標保證金、得標手續費、價款之繳存、扣繳、解交、匯款及申購截止日、公開抽籤日、申購處理費、中籤通知郵寄工本費或價款之繳存、扣繳、解交、匯款等作業，其後續作業一律順延至次一營業日辦理；另如係部份縣(市)停止上班，考量天

災係不可抗力之事由，無法歸責證券商，投資人仍應注意相關之風險。如投標保證金及投標處理費扣款日遇部分縣(市)停止上班但集中市場未休市時，投標保證金及投標處理費之扣繳日及其後續之開標日、未得標或不合格件保證金退款日、得標剩餘款項及得標手續費繳存往來銀行截止日及扣繳日、經紀商價款解交日、申購開始日至申購截止日、申購認購價款(以實際承銷價格為之)及處理費、郵寄工本費扣繳日、公開抽籤日、申購認購價款(以實際承銷價格為之)及處理費、郵寄工本費解交日等均順延至次一營業日辦理。

二十、該股票奉准上市以後之價格，應由證券市場買賣雙方供需情況決定，承銷商及發行公司不予干涉。

二十一、承銷價格決定方式(如附件一)。

二十二、律師法律意見書要旨：(如附件二)。

二十三、證券承銷商評估報告總結意見(如附件三)。

二十四、金融監督管理委員會或中華民國證券商業同業公會規定應行揭露事項：無。

二十五、其他為保護公益及投資人應補充揭露事項：詳見公開說明書。

【附件一】股票承銷價格計算書

一、承銷總股數說明

(一)鴻勁精密股份有限公司(以下簡稱鴻勁公司或該公司)股票初次申請上市時之實收資本額為新台幣 1,616,000,000 元，每股面額新台幣 10 元整，分為 161,600,000 股，該公司擬於股票初次申請上市案經主管機關審查通過後，辦理現金增資 183,300,000 元以辦理股票公開承銷作業，預計股票上市掛牌時之實收資本額為 1,799,300,000 元。

(二)依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第十一條及「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則補充規定」第十七之一條規定，公開發行公司初次申請股票上市時，至少應提出擬上市股份總額百分之十之股份，全數以現金增資發行新股之方式，於扣除依公司法相關法令規定保留供公司員工承購之股數後，委託證券承銷商辦理上市前公開銷售。但應提出承銷之股數超過二千萬股以上者，得以不低於二千萬股之股數辦理公開銷售。另若公開發行公司開始為興櫃股票櫃檯買賣未滿二年者，得扣除其前已依法提出供興櫃股票推薦證券商認購之股數，但扣除之股數不得逾提出承銷總股數之百分之三十。

(三)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」第二條第一項第一款規定，主辦承銷商應要求發行公司協調其股東就當次依法令規定委託證券商辦理公開承銷股數之百分之十五之額度(上限)，提供已發行普通股股票供主辦承銷商辦理過額配售；惟主辦承銷商得依市場需求決定過額配售數量。

(四)該公司截至 114 年 7 月 28 日止，記名股東人數共計 6,736 人，其中公司內部人及該等內部人持股逾百分之五十之法人以外之記名股東為 6,719 人，其所持有股份合計為 85,745,837 股，占已發行股份總額之 53.06%，已符合「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第四條有關股權分散之標準。

(五)綜上所述，該公司依擬上市股份總額之百分之十計算應提出公開承銷之股數，全數以現金增資發行新股之方式，委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，故擬辦理現金增資發行新股 18,330,000 股，扣除依公司法規定保留百分之十予員工優先認購之 1,833,000 股後，餘 16,497,000 股依據「證券交易法」第二十八之一條規定，業經 113 年 9 月 26 日股東臨時會決議通過由原股東全數放棄認購以辦理上市前公開承銷作業。另本證券承銷商已與該公司簽訂過額

配售協議，由該公司協調其股東提出不超過對外公開銷售股數之百分之十五，計 2,474,550 股為上限，提供已發行普通股股票供本證券承銷商辦理過額配售，屆時該公司及主辦承銷商再依市場需求決定實際過額配售數量。

二、承銷價格

(一)承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式及與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

1.承銷價格訂定所採用的方法、原則或計算方式

股票價值評估的方法很多種，各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異，目前市場上常用之股票評價方法包括市場法(如本益比法、股價淨值比法)、成本法(如淨值法)及收益法，茲分述如下：

(1)市場法

係透過已公開的資訊，和整個市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣同業公司之部分作折溢價的調整。市場上運用市價計算股價之方法為本益比法與股價淨值比法。本益比法及股價淨值比法係依據該公司之財務資料，計算每股盈餘及每股淨值，比較同業公司平均本益比及股價淨值比估算股價，最後再調整溢價和折價以反應與同業公司不同之處。

(2)成本法

成本法如淨值法係以帳面之歷史成本資料為公司價值評定之基礎，即以資產負債表帳面資產總額減去帳面負債總額，並考量資產及負債之市場價格而進行帳面價值之調整。

(3)收益法

收益法如現金流量折現法係根據該公司未來預估之獲利及現金流量，以涵蓋風險的折現率來折算現金流量，同時考慮實質現金及貨幣之時間價值。

茲就各種評價方法之優點、缺點及適用時機彙總說明如下：

方法	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
優點	1. 最具經濟效益與時效性，為一般投資人投資股票最常用之參考依據，具有相當之參考價值。 2. 所估算之價值與市場的股價較接近。 3. 較能反映市場、研判多空氣氛及投資價值認定。 4. 市場價格資料容易取得。	1. 淨值係長期且穩定之指標。 2. 當盈餘為負時之替代評估方法。 3. 市場價格資料容易取得。	1. 資料取得容易。 2. 使用財務報表之資料，較客觀公正。	1. 符合學理上對價值的推論，能依不同關鍵變數的預期來評價公司。 2. 較不受會計原則或會計政策不同而影響。 3. 反應企業之永續經營價值，並考量企業之成長性及風險。
缺點	1. 盈餘品質受會計方法之選擇所影響。 2. 即使身處同一產業，不	1. 帳面價值受會計方法之選擇所影響。	1. 資產帳面價值與市場價值差距甚大。	1. 使用程序繁瑣，需估計大量變數，花費成本大且不確定

方法	市場法		成本法	收益法
	本益比法	股價淨值比法	淨值法	現金流量折現法
	同公司間之本質上仍有相當差異。 3. 企業盈餘為負時不適用。	2. 即使身處同一產業，不同公司間之本質上仍有相當差異。	2. 未考量公司經營成效之優劣。 3. 不同種類資產需使用不同分析方法，且部分資產價值計算較為困難。	性高。 2. 對於投資者，現金流量觀念不易瞭解。 3. 預測期間較長。
適用時機	1. 企業生命週期屬成長型公司。 2. 獲利型公司。	1. 有鉅額資產但股價偏低的公司。 2. 獲利波動幅度較大之公司。	適合用於評估如傳統產業類股或公營事業。	1. 當可取得公司詳確的現金流量與資金成本的預測資訊時。 2. 企業經營穩定，無鉅額資本支出。

上述股價評價之各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦多有差異，其中因現金流量折現法係以未來各期所創造現金流量之折現值合計數認定為股東權益價值，由於未來之現金流量無法精確掌握，且評價使用之相關參數之參考價值相對較低下，國內實務上較少採用此方法。因此，以市場法作為股價評價之基礎。

2. 與適用國際慣用之市場法、成本法及收益法之比較

(1) 採樣同業之選擇

鴻勁公司為半導體 IC 測試及相關設備研發、製造及銷售之專業廠商，提供 IC 測試分選機及其相關設備整合性解決方案，並擁有高精度之溫控技術，聚焦高階半導體測試領域之應用，客戶涵括全球各大 IC 設計公司、封裝/測試廠及 IDM 半導體製造廠商。

綜觀目前國內上市櫃公司尚無業務內容與該公司完全相同者，考量營運規模、所屬產業上下游關聯性及產品應用領域後，選擇上市公司致茂電子股份有限公司(以下簡稱致茂公司，股票代碼：2360)，主要從事精密電子量測儀器、自動化測試系統、智慧製造系統與全方位 Turnkey 測試及自動化解決方案等業務；上市公司穎崴科技股份有限公司(以下簡稱穎崴公司，股票代碼：6515)，主要從事半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組等開發製造業務；上市公司辛耘企業股份有限公司(以下簡稱辛耘公司，股票代碼：3583) 主要提供半導體後段封裝濕製程設備研發製造及設備代理業務及上櫃公司旺矽科技股份有限公司(以下簡稱旺矽，股票代碼：6223) 主要從事晶圓探針卡及光電半導體自動化設備之生產銷售業務作為採樣同業。

(2)市場法

A.本益比法

單位：倍

月份 公司	114 年 8 月	114 年 9 月	114 年 10 月	平均本益比
致茂(2360)	32.04	34.94	41.71	36.23
穎崙(6515)	26.35	40.67	54.06	40.36
辛耘(3583)	29.90	31.15	30.37	30.47
旺矽(6223)	41.74	53.32	63.68	52.91
上市半導體類	21.33	23.68	27.07	24.03
上櫃半導體類	35.15	38.97	41.38	38.50

資料來源：臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站。

該公司採樣同業公司、上市半導體類股及上櫃半導體類股 114 年 8 月~114 年 10 月平均本益比區間約為 24.03~52.91 倍，以該公司最近四季之淨利 10,616,119 千元依擬上市掛牌股本 179,930 千股追溯調整之每股盈餘 59.00 元為基礎計算，價格區間約為 1,417.77~3,121.69 元，經考量該公司初次上市掛牌初期之成交量、流通性風險及股市環境等因素予以折價，該公司與本證券承銷商共同議定之承銷價格為每股 1,495 元，所商議之承銷價格落在參考價格區間，故雙方議定之承銷價格尚屬合理。

B.股價淨值比法

單位：倍

月份 公司	114 年 8 月	114 年 9 月	114 年 10 月	平均股價淨 值比
致茂(2360)	9.13	10.17	10.17	9.82
穎崙(6515)	7.72	15.54	15.54	12.93
辛耘(3583)	5.84	5.88	5.88	5.86
旺矽(6223)	11.51	18.40	18.40	16.10
上市半導體類	5.36	5.95	6.78	6.03
上櫃半導體類	3.12	3.46	3.68	3.42

資料來源：臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站。

該公司採樣同業公司、上市半導體類股及上櫃半導體類股 114 年 8 月~114 年 10 月平均股價淨值比區間約為 3.42~16.10 倍，以該公司 114 年前三季經會計師查核簽證之業主權益為 18,783,744 千元，依擬上市掛牌股本 179,930 千股計算之每股淨值 104.39 元為基礎計算，價格區間約為 357.01~1,680.68 元，惟股價淨值法使用歷史性財務資料，無法反映公司未來成長性，且較常用於評估獲利波動度較大或有鉅額資產但股價偏低之公司，故本證券承銷商不擬採用此法作為議定承銷價格參考之依據。

(3)成本法

成本法係為帳面價值法(Book Value Method)，帳面價值乃是投資人對公司請求權價值之總和，包含債權人、普通股投資人及特別股投資人等。其中，股票投資者對公司之請求權價值係公司資產總和扣除負債總額之淨資產價值。此種評價方式係以歷史成本為計算依據，將忽略通貨膨脹因素且無法表達資產實際經濟價值，並深受財務報表採行之

會計原則與方法影響，將可能低估成長型公司之企業價值，同時成本法使用上的限制有下列四項，因此國際上慣用成本法以評估企業價值者並不多見：

- A.無法表達目前真正及外來之經濟貢獻值。
- B.忽略了技術經濟壽命。
- C.技術廢舊及變革對於其所造成之風險無法預測。
- D.成本法中對於折舊項目及金額有量化的困難。

由於上述種種限制，故國際上採成本法評估企業價值者並不多見，且較常用於評估傳統產業類股或公營事業等，而該公司係屬成長型公司，因此本證券承銷商不擬採用此種方法做為承銷價格訂定之參考依據。

(4)現金流量折現法

A.模型介紹

現金流量折現法之理論依據，係認為企業價值應等於未來營運可能創造淨現金流量之現值總和，在多種理論模型中，以自由現金流量折現模式(Free Cash Flow Model)最能反映投資人之報酬率，其計算公式如下：

$$P_0 = V_E / N = (V_0 - V_D) / \text{Shares}$$

$$V_0 = \sum_{t=1}^{t=n} \frac{FCFF_t}{(1+K1)^t} + \sum_{t=n+1}^{t=m} \frac{FCFF_t}{(1+K1)^n \times (1+K2)^{t-n}} + \frac{FCFF_{m+1}}{(1+K1)^n \times (1+K2)^{m-n} \times (K3-G)}$$

$$FCFF_t = EBIT_t \times (1 - \text{tax rate}_t) + Dep_t \& Amo_t - Capital\ Exp_t - \Delta NWC_t$$

$$K_i = \frac{D}{A} \times K_d (1 - \text{tax rate}) + \frac{E}{A} \times K_e$$

$$K_e = R_f + \beta_j (R_m - R_f)$$

P_0	=	每股價值
V_0	=	企業總體價值 = $V_E + V_D$ = 股東權益價值 + 負債價值
N	=	擬上市股數 179,930 千股
$FCFF_t$	=	第 t 期之自由現金流量
K_i	=	加權平均資金成本 $i=1,2,3$
G	=	營業收入淨額成長率
N	=	5 第一階段之經營年限：114 年度～118 年度
M	=	10 第二階段之經營年限：119 年度～123 年度
$EBIT_t$	=	第 t 期之息前稅前淨利
tax rate_t	=	第 t 期之稅率
$Dep_t \& Amo_t$	=	第 t 期之折舊與攤銷費用

$Capital\ Exp_t$	=	第 t 期之資本支出
	=	第 t 期之購置固定資產支出
ΔNWC_t	=	第 t 期之淨營運資金變動數
	=	第 t 期之期初及期末流動資產－不付息流動負債之變動數
$D/(D+E)$	=	付息負債占付息負債及權益比
$E/(D+E)$	=	權益資產比 $=1-D/(D+E)$
Kd	=	負債資金成本率
Ke	=	權益資金成本率
Rf	=	無風險利率
Rm	=	市場平均報酬率
β_j	=	系統風險；衡量公司風險相對於市場風險之指標

B.股東權益資金成本率及自由現金流量之參數設定及計算結果

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
T	$t \leq n, n=5$	$n+1 \leq t \leq m, m=10$	$t \geq m+1$	依據該公司狀況分為三期間： 期間 I：114~118 年度 期間 II：119~123 年度 期間 III：124 年度後(永續經營期)
$D/(D+E)$	0.2854%	9.0888%	17.8922%	期間 I 依該公司最近三年度(111~113 年)及 114 年前三季之付息負債占(付息負債+權益)比率計算；期間 III 以採樣同業最近期付息負債占(付息負債+權益)比率預估；期間 II 採用期間 I 及期間 III 之平均數。
$E/(D+E)$	99.7146%	90.9112%	82.1078%	同上
Kd	2.3200%	2.1518%	1.9835%	期間 I 因該公司 111~112 年度及 114 年前三季並無借款，故依該公司 113 年度財務報告之借款利率估計；期間 III 採用最近五年度(109~113 年度) 本國銀行之借款平均利率計算；期間 II 採用期間 I 及期間 III 之平均數。
$tax\ rate$	20.0000%	20.0000%	20.0000%	以該公司現行主要營運地的所得稅率估計，採用財政部營利事業所得稅率 20%設算。
Rf	1.4469%	1.4469%	1.4469%	採用 114 年 9 月 30 日櫃買中心 10 年以上之加權平均公債殖利率以估計未來之無風險利率。
Rm	15.1057%	15.1057%	15.1057%	採用近十年(104~113 年度)發行人加權股價報酬指數之幾何平均投資報酬率以估計未來之市場報酬率。
β_j	1.3391	1.1695	1.000	期間I係採用台灣經濟新報料庫之各採樣同業最近五年度股價對集中交易市場大盤指數之風險係數，並取其平均值；期間III預期永續經營期之系統風險將逐步貼

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
				近市場之系統風險，故假設為1； 期間II之Beta值則取期間I與期間III 之平均值。
Ke	19.7371%	17.4214%	15.1057%	$=R_f + \beta * (R_m - R_f)$ 。其中 R_f ： 無風險報酬率； β ：類股與大盤走 勢之相關係數； R_m ：市場風險報 酬率
Ki	19.6874%	16.0336%	12.7579%	加權平均資金成本

C.自由現金流量之參數設定及計算結果

(A)保守情境

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
G	10.0842%	6.5821%	3.0800%	期間 I 係根據 WSTS 於 114 年 2 月發布之 全球半導體市場預測 2024~2029 年度之年 複合成長 10.0842%估計；期間 III 採用國 際貨幣基金組織(IMF)發布之預測未來五 年(114~118 年)全球實質 GDP 平均成長率 3.08%；期間 II 則取期間 I 與期間 III 之平 均值。
$EBIT_t / Sales_t$	47.4489%	47.4489%	47.4489%	係以該公司最近三年度(111~113 年)及 114 年前三季之平均息前稅前淨利率估 計。
$Dep_t / Sales_t$	0.2687%	0.2687%	0.2687%	係以該公司最近三年度(111~113 年)及 114 年前三季折舊費用占營業收入比率估 計。
$Capital\ Exp_t / Sales_t$	1.3565%	1.3565%	1.3565%	係以該公司最近三年度(111~113 年)及 114 年前三季平均資本支出占營業收入比 率估計。
$\triangle NWC_t / Sales_t$	8.0530%	8.0530%	8.0530%	係以該公司最近三年度(111~113 年)及 114 年前三季之淨增加營運資金占營業收 入比率來估計。

(B)樂觀情境

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
G	41.6000%	22.3400%	3.0800%	期間 I 係根據市場研究機構 GII(Global Information, Inc.)於 114 年 1 月發布之全球 AI 晶片市場規模 2024~2029 年度之年複 合成長率 41.6%估計；期間 III 採用國際 貨幣基金組織(IMF)發布之預測未來五年 (114~118 年)全球實質 GDP 平均成長率 3.08%；期間 II 則取期間 I 與期間 III 之平 均值。
$EBIT_t / Sales_t$	47.4489%	47.4489%	47.4489%	係以該公司最近三年度(111~113 年)及 114 年前三季之平均息前稅前淨利率估 計。
$Dep_t / Sales_t$	0.2687%	0.2687%	0.2687%	係以該公司最近三年度(111~113 年)及 114 年前三季折舊費用占營業收入比率估 計。

項目	期間I	期間II	期間III	基本假設說明
$Capital\ Exp_t / Sales_t$	1.3565%	1.3565%	1.3565%	係以該公司最近三年度(111~113 年)及114 年前三季平均資本支出占營業收入比率估計。
$\triangle NWC_t / Sales_t$	8.0530%	8.0530%	8.0530%	係以該公司最近三年度(111~113 年)及114 年前三季之淨增加營運資金占營業收入比率來估計。

D.每股價值之計算

(A)保守情境

$$\begin{aligned}
 P_0 &= (V_0 - V_D) / Shares \\
 &= (54,841,589 \text{ 千元} - 427 \text{ 千元}) / 179,930 \text{ 千股} \\
 &= 304.79 \text{ 元/股}
 \end{aligned}$$

(B)樂觀情境

$$\begin{aligned}
 P_0 &= (V_0 - V_D) / Shares \\
 &= (221,003,788 \text{ 千元} - 427 \text{ 千元}) / 179,930 \text{ 千股} \\
 &= 1,228.27 \text{ 元/股}
 \end{aligned}$$

依據上述假設及公式，該公司依自由現金流量折現法保守及樂觀情境假設計算之參考價格區間為 304.79~1,228.27 元，由於此法主要係以未來各期創造現金流量之折現值合計認定為股東權益價值，然因未來之現金流量無法精確掌握，評價方法所使用之相關參數，如未來營收成長率、資本支出之假設多為預估性質，在永續經營假設下，產業快速變化之特性使對未來之預估更具不確定性，較無法合理評估公司應有之價值，故在未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握情況下，且相關參數之參考價值相對較為主觀之情形下，本次承銷價格訂定不擬採用此方法評估。

(二)發行公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形

茲就該公司及其子公司與採樣同業公司致茂、穎歲、辛耘及旺矽之財務狀況、獲利情形及本益比之比較分析列示如下：

1.財務狀況

評估項目		年度	111 年度	112 年度	113 年度	114 年 前三季
		公司				
財務結構	負債占資產比率(%)	鴻勁	29.09	27.03	37.20	44.80
		致茂	35.34	32.75	31.78	30.35
		穎歲	35.15	28.43	26.91	25.16
		辛耘	75.50	78.92	78.87	74.46
		旺矽	36.77	38.74	43.52	47.46
		同業平均	46.5	44.10	41.80	註 2
	長期資金占不動產、廠房及設備比率(%)	鴻勁	739.00	697.37	733.07	933.84
		致茂	349.73	349.57	417.97	490.57
		穎歲	273.61	184.76	255.61	278.28
		辛耘	241.24	273.59	397.44	256.74
		旺矽	236.59	275.28	236.88	226.06
		同業平均	226.24	224.22	230.41	註 2
償	流動比率(%)	鴻勁	307.64	325.85	243.35	207.87

評估項目		年度 公司	111 年度	112 年度	113 年度	114 年 前三季
債 能 力		致茂	191.39	187.34	211.61	271.05
		穎崴	203.39	242.68	278.39	304.35
		辛耘	112.07	111.41	118.29	109.05
		旺矽	229.37	222.32	167.54	210.36
		同業平均	224.60	261.10	262.40	註 2
		鴻勁	198.34	234.62	137.50	126.49
	速動比率(%)	致茂	137.28	128.32	141.51	184.93
		穎崴	163.16	182.54	235.71	248.54
		辛耘	47.28	38.29	45.44	37.71
		旺矽	127.39	128.75	102.96	128.45
		同業平均	148.80	181.40	188.80	註 2
		鴻勁	6,379.83	17,352.09	16,065.55	17,641.91
	利息保障倍數 (倍)	致茂	117.97	86.16	151.17	492.02
		穎崴	1,431.52	179.32	99.76	474.67
		辛耘	217.18	188.56	72.42	51.40
		旺矽	106.49	61.66	92.25	42.35
		同業平均	3,730.60	2,390.00	3,166.40	註 2
經 營 能 力	應收款項週轉 率(次)	鴻勁	4.30	4.61	5.97	8.11
		致茂	4.13	3.26	3.38	3.59
		穎崴	4.08	2.91	4.24	4.30
		辛耘	5.60	7.89	13.14	15.08
		旺矽	5.82	6.51	5.90	6.27
		同業平均	4.80	4.20	4.40	註 2
	存貨週轉率 (次)	鴻勁	1.52	1.04	1.00	1.13
		致茂	2.47	1.68	1.75	1.58
		穎崴	5.00	3.44	4.89	5.63
		辛耘	0.93	0.63	0.64	0.67
		旺矽	1.51	1.55	1.48	1.44
		同業平均	2.50	2.40	2.60	註 2
	不動產、廠房 及設備週轉率 (次)	鴻勁	9.55	5.66	7.65	14.32
		致茂	3.37	2.63	3.06	3.75
		穎崴	4.80	2.12	2.66	3.36
		辛耘	4.10	4.49	6.12	5.52
		旺矽	2.13	2.39	2.56	2.26
		同業平均	3.10	2.50	2.60	註 2
	總資產週轉率 (次)	鴻勁	0.90	0.57	0.72	1.00
		致茂	0.70	0.55	0.61	0.65
		穎崴	1.06	0.70	0.93	0.97
		辛耘	0.49	0.41	0.46	0.49
		旺矽	0.71	0.70	0.70	0.68
		同業平均	0.60	0.50	0.50	註 2

資料來源：各公司之財務比率係取自各採樣同業各年度財務報告及年報、公開資訊觀測站、台灣經濟新報資料庫，並由元大證券計算整理。

註 1：同業資料為財團法人金融聯合徵信中心出版之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」；行業類別為「機械設備製造業」之財務比率。

註 2：截至評估報告出具日止，財團法人金融聯合徵信中心尚未出版 114 年前三季之同業 IFRSs 平均資料。

註 3：應收款項週轉率係採用應收款項總額計算。存貨週轉率係以存貨淨額計算。

註 4：114 年前三季之經營能力之財務比率均予以年化以利比較。

(1)財務結構

A.負債占資產比率

該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之負債占資產比率分別為 29.09%、27.03%、37.20%及 44.80%。112 年度負債占資產比率較 111 年度下降，主係 112 年因受到半導體景氣下行影響，該公司及其子公司減少採購原物料，降低庫存積壓風險，112 年底應付帳款餘額較 111 年底減少 44.81%，致 112 年負債比率較 111 年減少 7.08%；該公司及其子公司受惠於 113 年度半導體測試領域的強勁成長，該公司及其子公司對於感測器、溫度控制設備及機構加工件等半導體檢測設備所需零組件需求亦隨之增加，該公司及其子公司第四季採購較去年同期增加 441.26%，致 113 年底期末負債較去年同期增加 78.31%，負債比率因此上升；114 年前三季延續由 AI 所驅動的先進封測需求，客戶對於 AI、HPC 相關測試機台拉貨動能強勁，客戶預先支付設備款，造成 114 年前三季合約負債較 113 年底大幅增加 5,321,642 千元，致 114 年前三季度之負債占資產比率較 113 年度增加 20.43%。與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司之負債占資產比率，111 年度及 112 年度皆優於採樣同業及同業平均，113 年度及 114 年前三季則介於採樣同業及同業平均之間，顯示該公司及其子公司資金流相對穩定，財務風險較低，經評估其負債占資產比率之變化應無重大異常情事。

B.長期資金占不動產、廠房及設備比率

該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之長期資金占不動產、廠房及設備比率分別為 739.00%、697.37%、733.07%及 933.84%。112 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率較 111 年度下降，主係該公司及其子公司考量集團長期發展需要進而持續擴建廠房，致 112 年度不動產、廠房及設備成長率為 12.10%，造成該年度長期資金占不動產、廠房及設備比率下滑；113 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率較 112 年度上升，主係受惠人工智慧(AI)及高效能運算(HPC)應用需求強勁，隨著製程不斷微縮以及先進封裝(例如 Chiplet、CoWoS)導入，使半導體測試複雜度日益提升，帶動相關高階測試設備需求增加，使保留盈餘增加 485,929 千元，另 113 年度因辦理現金增資，股本增加 16,000 千元，資本公積增加 878,400 千元，連帶影響該公司及其子公司 113 年度權益總額大幅增加 1,416,395 千元，增加幅度為 11.50%，故 113 年度長期資金占不動產、廠房及設備比率上升至 733.07%；114 年前三季長期資金占不動產、廠房及設備比率較 113 年度上升，主係 AI、高效能運算等新興科技應用需求不墜，推升高端檢測設備需求，使 114 年前三季保留盈餘增加 5,014,627 千元，致該公司及其子公司 114 年前三季權益總額大幅增加 5,051,934 千元，增加幅度為 36.79%，故 114 年前三季長期資金占不動產、廠房及設備比率持續上升。與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之長期資金占不動產、廠房及設備比率均高於同業及同業平均之間，顯示該公司及其子公司長期資金尚足以支應不動產、廠房及設備之資金需求，其財務結構尚屬穩健，其變化情形尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之財務結構在營業規模成長及獲利連年挹注之下尚屬穩定，並無重大異常情形。

(2)償債能力

A.流動比率及速動比率

該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季流動比率分別為 307.64%、325.85%、243.35%及 207.87%，速動比率則分別為 198.34%、234.62%、137.50%及 126.49%。112 年度流動比率及速動比率均較 111 年度上升，主係 112 年受到半導體景氣下行影響，該公司及其子公司為有效控管庫存水位，減少採購原物料，112 年底應付帳款餘額較 111 年底減少 435,269 千元，使 112 年底流動負債較 111 年底減少 4.91%，故使 112 年度流動比率及速動比率相較 111 年度小幅提升；113 年度流動比率及速動比率均較 112 年度下降，主係受惠 AI、HPC 相關客戶訂單持續湧入，該公司及其子公司為因應後續生產所需，持續採購相關原物料，使期末應付帳款大幅增加 2,644,677 千元，使 113 年底流動負債較 112 年底增加 77.43%，故使 113 年度流動比率及速動比率均較 112 年度下降；114 年前三季流動比率及速動比率均較 113 年度下降，主係 AI/HPC 晶片之製程日益複雜及先進封裝等應用推動，市場對於半導體先進製程相關檢測設備的拉貨動能續強，客戶預先支付設備款，造成 114 年前三季合約負債較 113 年底大幅增加 5,321,642 千元，致 114 年前三季流動負債較 113 年底增加 221.89%，故使 114 年前三季流動比率及速動比率均較 113 年度下降。與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司流動比率及速動比率 111 年度及 112 年度均優於採樣同業及同業平均，113 年度及 114 年前三季則介於採樣同業及同業平均之間，顯示其財務結構尚屬穩健，其變化情形尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

B.利息保障倍數

該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之利息保障倍數分別為 6,379.83 倍、17,352.09 倍、16,065.55 倍及 17,641.91 倍。112 年度利息保障倍數較 111 年度上升，主係因該公司及其子公司於 111 年 3 月份全數償還帳上銀行長期借款，使 112 年之利息費用大幅下降，致 112 年度利息保障倍數大幅增加；113 年度利息保障倍數較 112 年度下降，主係大陸子公司為因應當地營運需求，向銀行增加借款約人民幣 3,500 萬元，造成利息負擔成本增加，利息費用較去年同期上升 85.71%，致 113 年度利息保障倍數下降；114 年前三季之利息保障倍數較 113 年度上升，主要係該公司持續受惠於人工智慧及高效能運算帶動之高階機台需求暢旺，推升整體營運獲利成長，致換算全年度之稅前純益增幅 117.78%大於利息費用增幅 98.40%，使 114 年前三季之利息保障倍數由 16,065.55 倍上升至 17,641.91 倍。與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之利息保障倍數均高於採樣同業及同業平均，顯示其財務結構尚屬穩健，其變化情形尚屬合理，經評估尚無重大異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司近年來積極拓展業務，營運績效顯著，故該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之償債能力指標變化情形尚屬合理，尚無重大異常之情事。

(3)經營能力

A.應收帳款週轉率

在應收款項週轉率方面，該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季度之應收款項週轉率分別為 4.30 次、4.61 次、5.97 次及 8.11 次，應收款項收現天數分別為 84.88 天、79.18 天、61.14 天及 45.01 天，尚介於正常之授信期間內。主係因 112 年受全球總體經濟疲軟及維持高檔的通貨膨脹和利率，相關半導體廠延後資本支出，使該公司及其子公司 112 年度營業收入較 111 年度營業收入降低 29.55%，惟該公司及其子公司強化應收帳款收款力道，致 112 年底應收款項總額較 111 年度減少，112 年度平均應收帳款較 111 年度降低 34.41%，綜上所述，營業收入降低幅度小於平均應收款項總額，致應收款項週轉率因而增加；113 年底應收款項週轉率較 112 年底上升，主係受惠於生成式 AI 蓬勃發展，相關晶片需要運用最先進的半導體技術和封裝解決方案，且隨著全球半導體供應鏈復甦，推動半導體廠商加速擴充產能，反映於該公司及其子公司 113 年度業績大幅成長，該公司及其子公司亦加強控管應收帳款收款力道，使收款效率加速，113 年度應收款項週轉率因此上升；114 年前三季應收款項週轉率較 113 年底上升，主係因先進製程及封裝技術的持續發展，帶動半導體檢測設備需求持續熱絡，換算全年度之營業收入成長 100.06%，使 114 年前三季應收款項週轉率持續上升。與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之應收款項週轉率均介於採樣同業及同業平均之間，且該公司及其子公司之往來客戶大多為國內外知名廠商，財務與營運狀況皆屬穩健，且該公司及其子公司定期追蹤應收帳款期後收回情形，整體而言並無重大異常情事。

B.存貨週轉率

在存貨週轉率及存貨週轉天數方面，該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之存貨週轉率分別為 1.52 次、1.04 次、1.00 次及 1.13 次，存貨週轉天數分別為 240.13 天、350.96 天、365.00 天及 323.01 天。112 年度存貨週轉率較 111 年度下降，主係 112 年受到半導體景氣下行影響，該公司及其子公司為有效控管庫存水位，減少採購原物料，致 112 年度期末存貨總額呈現減少之趨勢，也使 112 年度平均存貨較去年同期下降 2.68%，但因終端客戶同樣處於庫存去化階段，各半導體大廠客戶資本支出放緩，該公司及其子公司營收規模衰退 29.55%，伴隨營業成本同步下滑 33.35%，由於營業成本下滑幅度大於平均存貨，綜上所述該公司及其子公司 112 年存貨週轉率由 1.52 次下降至 1.04 次，存貨週轉天數則由 240.13 天拉長至 350.96 天；113 年度存貨週轉率較 112 年度微幅下降，主係受惠 AI、HPC 相關客戶訂單持續湧入，該公司及其子公司為因應後續生產所需，持續採購相關原物料以及製造完成待客戶驗收之存貨增加，故 113 年度期末存貨總額呈現成長之趨勢，113 年度平均存貨較 112 年度上升 36.22%，致 113 年度存貨週轉率由 1.04 次微幅下降至 1.00 次，存貨週轉天數則由 350.96 天略升至 365.00 天；114 年前三季之存貨週轉率較 113 年度上升，主係營收受惠於下游半導體銷貨客戶因高速運算、人工智慧等對半導體之需求而增加，該公司及其子公司積極備料以為因應且配合需求製成品存貨大幅增加，在營業成本增幅 85.06%大於平均存貨淨額增幅 64.98%的影響下，114 年前三季之存貨週轉率由 1.00 次上升至 1.13 次，存貨週轉天數則由 365.00 天下降至 323.01

天。與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之存貨週轉率均介於採樣同業及同業平均之間，經評估應無重大異常情事。

C.不動產、廠房及設備週轉率及總資產週轉率

該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季不動產、廠房及設備週轉率分別為 9.55 次、5.66 次、7.65 次及 14.32 次。112 年度不動產、廠房及設備週轉率較 111 年度下降，主係 112 年度半導體市場受終端需求疲軟以及客戶遞延出貨等影響，營業收入較 111 年度下滑 29.55%，而公司考量營運需求而持續建置新廠，導致不動產、廠房及設備增加，使得不動產、廠房及設備週轉率降低至 5.66 次；113 年度不動產、廠房及設備週轉率較 112 年度上升，主係受惠於人工智慧技術的迅速崛起，帶動全球半導體供應鏈復甦，反映於該公司及其子公司 113 年度業績大幅成長，營業收入較去年同期增加 47.45%，致該公司及其子公司 113 年底不動產、廠房及設備週轉率上升至 7.65 次；114 年前三季止之不動產、廠房及設備週轉率較 113 年度上升，主係 114 年前三季持續受惠半導體先進封裝技術的發展，換算全年度之營收成長 100.06%，惟該公司及其子公司之新廠已於 113 年陸續完工，114 年前三季已無大額資本支出需求，平均不動產、廠房及設備之淨額僅微幅上升 6.87%，致不動產、廠房及設備週轉率上升至 14.32 次。與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之不動產、廠房及設備週轉率均優於採樣同業及同業平均之間，經評估應無重大異常情事。

該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季總資產週轉率分別為 0.90 次、0.57 次、0.72 次及 1.00 次，112 年度總資產週轉率較 111 年度下降，主係 112 年度半導體景氣下行影響，該公司及其子公司 112 年營業收入較 111 年度衰退約 29.55%，致 112 年度之總資產週轉率下降；113 年度總資產週轉率較 112 年度上升，主係因 AI 晶片技術持續提升，IC 晶片結構更趨複雜，製程中的良率下降，IC 半導體相關產業為了維持良率，持續增加資本支出及擴充產能，反映於該公司及其子公司 113 年度業績大幅成長，營業收入較去年同期增加 47.45%，再加上該公司及其子公司為因應後續生產所需，持續採購相關原物料，使 113 年度平均資產總額較 112 年度成長 16.30%，綜上所述，113 年度營業收入成長幅度大於平均資產總額成長幅度，致總資產週轉率上升；114 年前三季總資產週轉率較 113 年度上升，主係在 AI 和高效能運算需求持續強勁，以及客戶端拉貨動能挹注下，114 年前三季換算全年度之營收較 113 年度成長 100.06%，致 114 年前三季之總資產週轉率上升至 1.00 次。與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 111~113 年度總資產週轉率均介於採樣同業及同業平均之間，且 114 年前三季之總資產週轉率均優於採樣同業，相關比率之變動經評估尚無異常之情事。

整體而言，該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之經營能力指標變動情形尚屬合理，與同業相較尚無重大異常情事。

2.獲利情形

評估項目		年度 公司	111 年度	112 年度	113 年度	114 年 前三季
獲利能力	權益報酬率 (%)	鴻勁	45.06	25.60	40.59	70.95
		致茂	25.61	18.37	22.48	44.57
		穎歲	33.21	12.92	26.27	27.72
		辛耘	16.94	17.18	20.71	19.41
		旺矽	18.73	18.05	27.17	29.39
		同業平均	11.00	6.30	7.30	註 2
	營業利益占實 收資本額比率 (%)	鴻勁	1,066.20	235.37	388.90	902.81
		致茂	118.46	109.85	128.89	194.69
		穎歲	388.65	160.11	381.91	590.03
		辛耘	87.54	89.35	138.87	190.77
		旺矽	132.68	156.14	263.47	395.41
		同業平均	註 3	註 3	註 3	註 2
	稅前純益占實 收資本額比率 (%)	鴻勁	1,211.81	242.92	413.54	900.60
		致茂	151.42	121.45	157.73	329.52
		穎歲	398.86	161.33	400.46	551.10
		辛耘	90.69	107.10	158.94	178.08
		旺矽	153.45	167.92	296.58	378.77
		同業平均	註 3	註 3	註 3	註 2
	純益率(%)	鴻勁	32.41	32.33	37.78	41.20
		致茂	23.14	21.31	24.37	47.02
		穎歲	21.48	12.60	20.45	21.15
		辛耘	10.06	9.41	9.57	9.33
		旺矽	16.36	16.07	22.61	23.36
		同業平均	10.20	6.30	5.20	註 2
	每股稅後盈餘 (元)	鴻勁	27.22	19.17	32.95	53.54
		致茂	12.14	9.45	12.49	21.67
		穎歲	32.22	13.52	34.31	33.40
		辛耘	7.08	8.10	11.54	9.71
		旺矽	12.89	13.92	24.42	23.65
		同業平均	註 3	註 3	註 3	註 2

資料來源：各公司之財務比率係取自各採樣同業各年度財務報告及年報、公開資訊觀測站、台灣經濟新報資料庫，並由元大證券計算整理。

註 1：同業資料為財團法人金融聯合徵信中心出版之「中華民國台灣地區主要行業財務比率」；行業類別為「機械設備製造業」之財務比率。

註 2：截至評估報告出具日止，財團法人金融聯合徵信中心尚未出版 114 年前三季之同業 IFRSs 平均資料。

註 3：財團法人金融聯合徵信中心編印之「中華民國臺灣地區主要行業財務比率」未揭露該等資訊。

註 4：114 年前三季之獲利能力(除純益率、每股稅後盈餘)之財務比率均予以年化以利比較。

(1)權益報酬率

該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之權益報酬率分別為 45.06%、25.60%、40.59%及 70.95%。112 年度權益報酬率較 111 年度下滑，主係因 112 年全球經濟疲軟及半導體景氣下行影響，終端客戶處於庫存調整階段，各半導體廠客戶放緩資本支出縮減下單需求，使該公司及其子公司 112 年度營業收入較前一年度衰退 29.55%，連帶使 112 年稅後純益較 2022 年度下滑約 29.73%，致 112 年度權益報酬率較 111 年度下滑至 25.60%；113 年度權益報酬率較 112 年度上升，主係受惠於 AI 蓬勃發展，相關晶片需要

運用最先進的半導體技術和封裝解決方案，且隨著全球半導體供應鏈復甦，推動半導體廠商加速擴充產能，反映於該公司及其子公司 113 年度業績大幅成長，113 年度稅後淨利較 112 年度增加 72.30%，致 113 年權益報酬率較 112 年度上升至 40.59%；114 年前三季權益報酬率較 113 年度提升，主係 114 年前三季延續受惠於先進製程帶動整體封裝產業鏈持續擴充產能，換算全年度之獲利增幅 118.21%大於平均權益增幅 24.83%，致 114 年前三季之權益報酬率成長至 70.95%。與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 111～113 年度及 114 年前三季之權益報酬率均高於採樣同業及同業平均，顯見該公司及其子公司為股東創造利潤之能力尚稱良好，經評估其權益報酬率之變化應無重大異常情事。

(2)營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率

該公司及其子公司 111～113 年度及 114 年前三季營業利益占實收資本額比率分別為 1,066.20%、235.37%、388.90%及 902.81%，稅前純益占實收資本額比率則分別為 1,211.81%、242.92%、413.54%及 900.60%。該公司及其子公司受到 112 年全球經濟疲軟及半導體景氣下行影響，終端客戶處於庫存調整階段，各半導體廠客戶放緩資本支出需求，致 112 年度營業利益及稅前純益分別較前一年度衰退 24.77%及 31.69%，此外該公司及其子公司於 112 年度辦理盈餘轉增資 1,130,462 千元，實收資本額由 469,538 千元增加至 1,600,000 千元，上升 240.76%，綜上導致營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率下降；113 年受惠於全球半導體市場景氣回暖，客戶訂單增加且出貨情形順暢，反映於該公司及其子公司 113 年度業績大幅成長，使 113 年度營業利益及稅前純益分別較 112 年度增加 66.88%及 71.94%，導致 113 年度營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率分別上升至 388.90%及 413.54%；114 年前三季在半導體先進製程相關檢測設備的拉貨動能續強的狀況下，換算全年度之營業利益及稅前純益較去年增加 132.14%及 117.78%，致 114 年前三季換算全年之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率皆較 113 年度上升。與採樣同業相較，該公司及其子公司之營業利益占實收資本額比率及稅前純益占實收資本額比率 111～113 年度及 114 年前三季均高於同業，顯示該公司及其子公司之獲利能力良好且穩定發展，經評估上述比率之變化應無重大異常情事。

(3)純益率及每股盈餘

該公司及其子公司 111～113 年度及 114 年前三季純益率分別為 32.41%、32.33%、37.78%及 41.20%，每股盈餘則分別為 27.22 元、19.17 元、32.95 元及 53.54 元。112 年純益率較 111 年度下滑，除受到 112 年全球經濟疲軟及半導體景氣下行影響，終端客戶處於庫存調整階段，各半導體廠客戶放緩資本支出縮減下單需求，使該公司及其子公司 112 年度營業收入較前一年度衰退 29.55%之外，另因該公司及其子公司外銷主要以美金計價，111 年受疫情、戰爭使全球通膨高漲，在風險趨避以及利差因素下，資金湧入美元市場，造成台幣貶值較嚴重，111 年度因此認列外幣兌換利益 652,590 千元，112 年美金雖仍屬強勢，惟整體匯率走勢坡度逐漸趨緩，112 年度認列外幣兌換利益 42,237 千元，故使 112 年度外幣兌換淨利益較 111 年度減少 93.53%，致 112 年純益率較前一年度下滑。112 年度每股盈餘較 111 年度下滑，主係因受到半導體景氣疲軟影響，半導體大廠放緩資本支出腳步，延後拉貨導致該公司及其子公司 112 年度稅後純益較前一年度衰退 29.73%，使該公

司及其子公司 112 年每股盈餘因而較 111 年度下滑；113 年度受惠 AI 帶動先進製程與先進封裝需求大爆發，搭配全球晶圓廠持續建廠擴充產能，且隨著營業規模成長及 AI/HPC 應用之高毛利產品營收占比持續提升，致該公司及其子公司 113 年度稅後淨利較 112 年度成長 72.30%，純益率及每股盈餘因此上升；114 年前三季在 AI 浪潮的推動全球半導體先進封裝設備的發展及需求，換算全年度之稅後淨利較去年增加 118.21%，純益率及每股盈餘因此增加。與採樣同業及同業平均相較，該公司及其子公司 111~113 年度之純益率均高於同業及同業平均，且 114 年前三季之純益率介於採樣同業之間，而該公司及其子公司 112 年度及 114 年前三季之每股盈餘均優於採樣同業，111 年度及 113 年度之每股盈餘則均介於同業之間，顯示該公司及其子公司獲利能力良好，經評估尚無重大異常情事。

整體而言，該公司及其子公司 111~113 年度及 114 年前三季之獲利能力各項指標之變化尚屬合理，經評估應無重大異常之情事。

3.本益比

請詳前述(一)2.(2)A.之評估說明。

(三)所議定之承銷價格若參考財務專家意見或鑑價機構之鑑價報告者，應說明該專家意見或鑑價報告內容及結論

本次承銷價格之議訂並無採取專家意見或鑑價報告。

(四)發行公司於興櫃市場掛牌之最近一個月平均股價及成交量資料

鴻勁公司於 113 年 10 月 31 日於興櫃市場掛牌，最近一個月(114 年 10 月 18 日~114 年 11 月 17 日)之月平均股價及總成交量分別為 2,298.43 元及 31,458 千股。

(五)證券承銷商就其與發行公司所共同議定承銷價格合理性之評估意見

本證券承銷商經考量該公司之獲利能力、產業未來發展前景及初次上市股票流動性等因素，並參酌採樣同業之本益比以及該公司最近一個月興櫃市場之平均成交價等方式，以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂定最低承銷價格為每股新臺幣 1,196 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格新台幣 2,030.37 元為之，並以最低承銷價格之 1.25 倍為上限，故公開申購承銷價格以每股新台幣 1,495 元溢價發行，尚屬合理。

發 行 公 司：	鴻勁精密股份有限公司	代表人：	謝昺達
主辦證券承銷商：	元大證券股份有限公司	代表人：	陳修偉
主辦證券承銷商：	富邦綜合證券股份有限公司	代表人：	程明乾
協辦證券承銷商：	中國信託綜合證券股份有限公司	代表人：	謝載祥
協辦證券承銷商：	玉山綜合證券股份有限公司	代表人：	陳烜台
協辦證券承銷商：	第一金證券股份有限公司	代表人：	陳致全

【附件二】律師法律意見書

鴻勁精密股份有限公司本次為辦理初次上市前現金增資發行新股，募集與發行普通股 18,330,000 股，每股面額新台幣 10 元，發行總金額為新台幣 183,300,000 元整，向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。經本律師採取必要審核程序，包括實地瞭解，與公司董事、經理人及相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證公司議事錄、重要契約及其他相關文件、資料，並參酌相關專家之意見等。特依「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，出具本律師法律意見書。

依本律師意見，鴻勁精密股份有限公司本次向臺灣證券交易所股份有限公司提出之法律事項檢查表所載事項，並未發現有違反法令致影響有價證券募集與發行之情事。

翰辰法律事務所 邱雅文律師

【附件三】證券承銷商評估報告總結意見

鴻勁精密股份有限公司本次為辦理現金增資發行普通股 18,330 千股，每股面額新台幣壹拾元整，合計發行總金額為新台幣 183,300 千元，依法向臺灣證券交易所股份有限公司提出申報。業經本承銷商採用必要之輔導及評估程序，包括實地了解鴻勁精密股份有限公司之營運狀況，與公司董事、經理人及其他相關人員面談或舉行會議，蒐集、整理、查證及比較分析相關資料等，予以審慎評估。特依金融監督管理委員會「發行人募集與發行有價證券處理準則」及中華民國證券商業同業公會「發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告應行記載事項要點」及「證券承銷商受託辦理發行人募集與發行有價證券承銷商評估報告之評估查核程序」規定，出具本承銷商總結意見。

依本承銷商之意見，鴻勁精密股份有限公司本次募集與發行有價證券符合「發行人募集與發行有價證券處理準則」及相關法令之規定，暨其計畫具可行性及必要性，其資金用途、進度及預計可能產生效益亦具合理性。

元大證券股份有限公司

負 責 人：陳修偉
承銷部門主管：江淑華

※反詐騙提醒：不聽來源不明資訊、不加陌生投資群組、不用保證獲利 APP 與投資平台。可撥打 165 反詐騙專線請求協助。